

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการผลิต “Improve Phase Element	33
4.1 แสดงจากปัจจัยต่างๆของแผนภูมิ SIPOC.....	52
4.2 การปรับปรุงโดยการทำให้แผนภูมิกำกวม.....	54
4.3 แสดงตารางการประเมินระดับความรุนแรงของปัญหา.....	55
4.4 แสดงตารางโอกาสการเกิดผลกระทบ.....	56
4.5 แสดงตารางการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้.....	57
4.6 แสดงตัวอย่างตาราง FMEA.....	58
4.7 แสดงความรุนแรงของความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเนื่องจากการซบ วงจรรวม.....	61
4.8 แสดงการวิเคราะห์ FMEA ของกระบวนการซบนิกเกิลบนแผ่นทองแดง.....	62
4.9 แสดงการวิเคราะห์ FMEA ของกระบวนการซบดีบุกบนแผ่นทองแดง.....	63
4.10 แสดงการปรับปรุงโดยวิธีการทาง FMEA.....	65
4.11 ตารางแสดงสัดส่วนร้อยละการเกิดของเสียในระบบการซบก่อนการปรับปรุง เดือนสิงหาคม 2008.....	67
4.12 แสดงหลักการให้คะแนนที่ใช้กับ แผนภูมิเหตุและผล.....	69
4.13 แสดงตาราง แผนภูมิเหตุและผล (Cause& Effect diagram).....	70
4.14 แสดงตารางสรุปคะแนน แผนภูมิเหตุและผล (Cause& Effect diagram).....	71
4.15 แสดงการทดสอบการวัดความหนาของการซบโดยวิธี GR&R.....	72
4.16 แสดงค่าการวัดเปรียบเทียบของพนักงานวัดทั้งสองคน.....	76
4.17 ค่าการวัดหลังการปรับปรุง Gauge R&R.....	81
4.18 แสดงการวัดค่าความหนาของนิกเกิล.....	85
4.19 แสดงข้อมูลการซบดีบุก.....	86
4.20 แสดงพารามิเตอร์หลักที่ใช้ควบคุมการซบ.....	88
4.21 แสดงข้อมูลที่ใช้ในการทดลองหา DOE.....	89
4.22 แสดงแนวโน้มความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ที่มีผลต่อความหนาของการซบ...	94
5.1 แสดงการเปรียบเทียบของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง.....	105
5.2 แสดงการเปรียบเทียบ Yield ก่อนและหลังการปรับปรุง.....	105